

國家科學及技術委員會新聞稿附件

第 33 次園區審議會核准投資案

一、欣亞中康能源股份有限公司(設立於中部科學園區之臺中園區)

本案投資金額 12 億元，協助台灣康寧公司台中廠建置自發自用天然氣發電機組，並提供施工安裝及後續能源營運管理等專業技術服務。

本案公司引進先進國家高效率天然氣發電機組，擁有低碳排及低排氣的優良特性，並具有最新混氫技術，可就近發電提供康寧廠內自用電力，大幅減少碳排放量以及能源傳輸損耗，並具備快速調度能力，可有效回應廠區電力需求，以確保廠區供電穩定，亦可減輕台電公司在尖峰與半尖峰的電力調度壓力，符合政府對用電大戶自建電力機組或儲能設備之能源政策，協助企業朝淨零碳排及永續經營理念邁進。

二、濰元科技股份有限公司(設立於中部科學園區之臺中園區)

本案投資金額 2 億元，主要產品為可攜式衛星地面通訊解決方案、無人載具通訊解決方案以及前瞻 6G 通訊技術。

本案公司專注於新世代通訊技術研發，推出整合相位陣列天線與 MCU 的便攜式多軌衛星終端模組，透過電子波束掃描靈活支援低、中、同步軌道(LEO/MEO/GEO)訊號，具備輕量、低耗電與快速部署等優勢。針對無人載具，該公司開發專屬抗干擾射頻模組，結合高頻、移頻與跳頻技術，並確保在 GPS 受干擾的極端環境下仍能精準定位並維持高韌性連線，滿足軍工國防的高標準需求。面向 6G 與地面以及 NTN(非地面網路)新世代通訊，濰元科技整合低軌衛星核心元件與先進 RF 技術，透過設備微型化與效能優化，打造高頻寬、低延遲且高可靠的通訊解決方案，全面驅動國防、防災與商務應用，實現天地一體化連結新未來。

三、衡信分析科技股份有限公司(設立於新竹科學園區之新竹園區)

本案投資金額 6 億元，主要產品為先進樣品製備分析服務(ASPA)、電性故障分析服務(EFA)及物性故障分析服務(PFA)等半導體故障分析相關技術服務。

本案公司為衡陞科技股份有限公司為落實集團專業分工所設立之子公司，規劃建置 2 奈米及以下先進製程之電性量測分析平台，專責高階故障分析服

務。本案公司為業界首家從先進製程晶片電性故障分析為核心出發，結合奈米探針技術與高階分析設備，能精準鎖定複雜晶片的故障位置並提高故障分析的成功率，為半導體客戶提供高解析度與高靈敏度之量測解決方案，協助客戶提升於研發導入、製程優化與量產驗證等不同階段的分析效率與決策品質。

本案公司進駐將有助於提升園區高階半導體分析與檢測服務量能，強化先進製程技術自主性，增強我國半導體產業整體競爭力。

四、漢泰先進材料股份有限公司銅科分公司（設立於新竹科學園區之銅鑼園區）

本案投資金額 3.5 億元，主要開發半導體級 ESD 功能材料與表面工程整合平台。

本案公司專注於發展高附加價值功能性表面工程技術，以 ESD 防靜電功能性鍍膜為基礎，建構跨製程之功能性鍍膜技術平台，透過整合 ESD 防靜電鍍膜、耐磨鍍膜及高均勻性薄膜等技術，協助客戶在不改變既有基礎製程條件下，有效提升設備零組件於實際製程環境中的靜電防護能力、耐磨耗表現及整體可靠度，為半導體產業中所需關鍵技術。本案並將傳統單一表面處理加工模式，升級為技術導向的製程優化解決方案，提升整體技術層級與產業價值。

本案進駐園區有助於提升國內自主表面工程技術，降低國內高階設備關鍵零組件對國外鍍膜與材料服務的依賴性，提升我國半導體設備與材料產業之國際競爭力。

五、合聖科技股份有限公司竹南分公司（設立於新竹科學園區之竹南園區）

本案投資金額 2 億元，核心產品涵蓋外部雷射光源模組(ELS)、具超穎透鏡之光纖陣列模組(FAU)及矽光子相關產品與應用技術服務。

本案公司掌握矽光子共封裝技術（Co-Packaged Optics, CPO）之關鍵光學零組件技術，這項優勢使其能夠直接對接國際一線客戶的嚴格需求，針對 AI 資料中心及 CPO 等前瞻應用，提供具備高整合度的解決方案。

本案公司透過設立竹南分公司不僅能大幅提升公司整體的營運績效，更展現了深耕臺灣矽光子產業鏈的強烈決心，預期將帶動國內光電與半導體封裝領域的技術發展與高階人才培育，確保臺灣在競爭激烈的全球 AI 市場中持

續保持領先優勢。

六、台灣迪恩士半導體科技股份有限公司竹科分公司（設立於新竹科學園區之新竹園區）

本案投資金額 1 億元，主要產品為從事晶圓洗淨設備之研發及技術服務。

本案公司產品項目涵蓋單片式、批次式及旋刷式晶圓洗淨設備，可對應 16 奈米以下至 2 奈米及 1.4 奈米以下等先進半導體製程需求。核心技術包含先進乾燥技術、精準物理洗淨技術及高可靠度模組化設備設計，有助提升製程良率、降低設備停機風險，並強化整體生產效率。

台灣迪恩士半導體科技股份有限公司為日商 SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. 於臺灣全資子公司，長期深耕半導體先進製程設備領域。本次設立竹科分公司，除承接日本母公司之關鍵專利與技術授權外，亦將推動在地研發能量、客製化設備改造及即時技術服務，深化與國內半導體產業之合作。

未來本案公司將結合 ESG 節能與水資源再利用技術，協助半導體產業朝向高效率與永續發展，促進新竹科學園區高階半導體設備產業聚落之成長。

七、竹路應用材料股份有限公司橋科分公司（設立於南部科學園區之橋頭園區）

本案投資金額 1.8 億元，主要產品為高值化氮化鋁粉末之研發與製造。

本案公司致力於提升國內高階電子材料自主供應能力，其產品兼具高絕緣性與高導熱特性，廣泛應用於電動車、半導體封裝、高功率電子元件及散熱材料等領域。未來進駐園區後，公司將持續深耕先進氮化鋁粉體材料技術研發，強化半導體關鍵材料自主供應能力，推升高端先進材料國產化與在地化發展。